

# Technische Produktinformation

## ELSOLD Lotpaste AP-10 Sn63Pb37 | Sn62Pb36Ag2

### Produktbeschreibung

Lotpaste AP-10 ist eine aktivierte bleihaltige Lotpaste auf Basis von modifizierten, natürlichen Harzen, geeignet für den Reflowprozess an Luft oder unter Stickstoff. Lotpaste AP-10 hat ein breites Prozessfenster und bietet eine gute Aktivität auf nahezu allen Metallisierungen. AP-10 ist für einfache Anwendungen in der Nachrichtentechnik, Mikroelektronik und an gedruckten Schaltungen geeignet.

Die Paste ist robust und hat eine lange Offenzeit. Druckpausen bis zu 60 min sind möglich, wobei bei weniger feinen Strukturen ein Probedruck nicht erforderlich ist. Die Flussmittelrückstände sind hellbernsteinfarben, nicht korrosiv und müssen in den meisten Fällen nicht entfernt werden. Ist ein Waschen erforderlich, sind die Rückstände gut abwaschbar mit Alkoholen und Gemischen aus halogenierten Kohlenwasserstoffen und Alkoholen.

- Gute Benetzung auf den üblichen metallischen Oberflächen
- Gute Dosierbarkeit
- Hohe Aktivität auf allen Substraten
- Gute Klebrigkeit bis 8 h
- Flussmittelklassifizierung: J-STD-004: ROL1
- Geeignet für alle Lötverfahren mit indirekter Erwärmung
- Gute Waschbarkeit der Flussmittelrückstände
- Lange Offenzeit

### Testergebnisse

#### Klebrigkeit: > 8 h

#### Konturenstabilität: Bestanden

IPC-TM-650, Methode 2.4.35

#### Solder Balling Test: Bestanden

IPC-TM-650, Methode 2.4.43

#### Kupferspiegeltest: L

IPC-TM-650, Methode 2.3.3

#### Silberchromatetest: Bestanden

IPC-TM-650, Methode 2.3.35

### Isolationswiderstand

J-STD-0004, IPC-TM-650, Methode 2.6.3.3

AP-10, ungereinigt nach 24 h:	9.6 x 10 <sup>8</sup> Ω
AP-10, ungereinigt nach 96 h:	1.0 x 10 <sup>9</sup> Ω
AP-10, ungereinigt nach 168 h:	1.0 x 10 <sup>9</sup> Ω
Kontrollbord nach 24 h:	1.1 x 10 <sup>10</sup> Ω
Kontrollbord nach 96 h:	1.2 x 10 <sup>10</sup> Ω
Kontrollbord nach 168 h:	1.2 x 10 <sup>10</sup> Ω

Für die Lotpaste AP-10 Sn63Pb37 T3 90 % liegt ein Prüfbericht der Siemens AG vor, der bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden kann.

### Physikalische Eigenschaften

Daten für SnPb(Ag)-Lote, 86 – 90 % Metallgehalt, Pulvertyp 3, 25 – 45 µm

Viskosität 500 – 800 Pa·s

Legierung	Sn [%]	Pb [%]	Ag [%]	Scmelzpunkt [°C]
S-Sn63Pb37	63 ± 0.5	37 ± 0.5	-	183
S-Sn62Pb36Ag2	62 ± 0.5	36 ± 0.5	2 ± 0.2	179

### Anwendung

Die Lotpaste AP-10 kann im Dispensier- Schablonen- oder Siebdruckverfahren aufgebracht werden.

# Technische Produktinformation

## ELSOLD Lotpaste AP-10 Sn63Pb37 | Sn62Pb36Ag2

### Reinigung

AP-10 ist eine no clean Paste. Die Rückstände müssen nicht entfernt werden, können aber mit Lösungsmitteln wie Ethanol, Isopropanol oder Gemischen aus Alkohol und halogenierten Kohlenwasserstoffen leicht gelöst werden, falls dies erforderlich ist.

### Verpackung

Dosen: 250 g und 500 g | Kartuschen: 600 g und 1200 g (SEMCO) | Spritzen: 10 ccm und 30 ccm

### Lagerung und Lagerfähigkeit

Dosen: maximal 6 Monate im geschlossenen Behälter bei 6 – 16 °C

Kartuschen: maximal 3 Monate senkrecht stehend bei 6 – 16 °C

### Druck

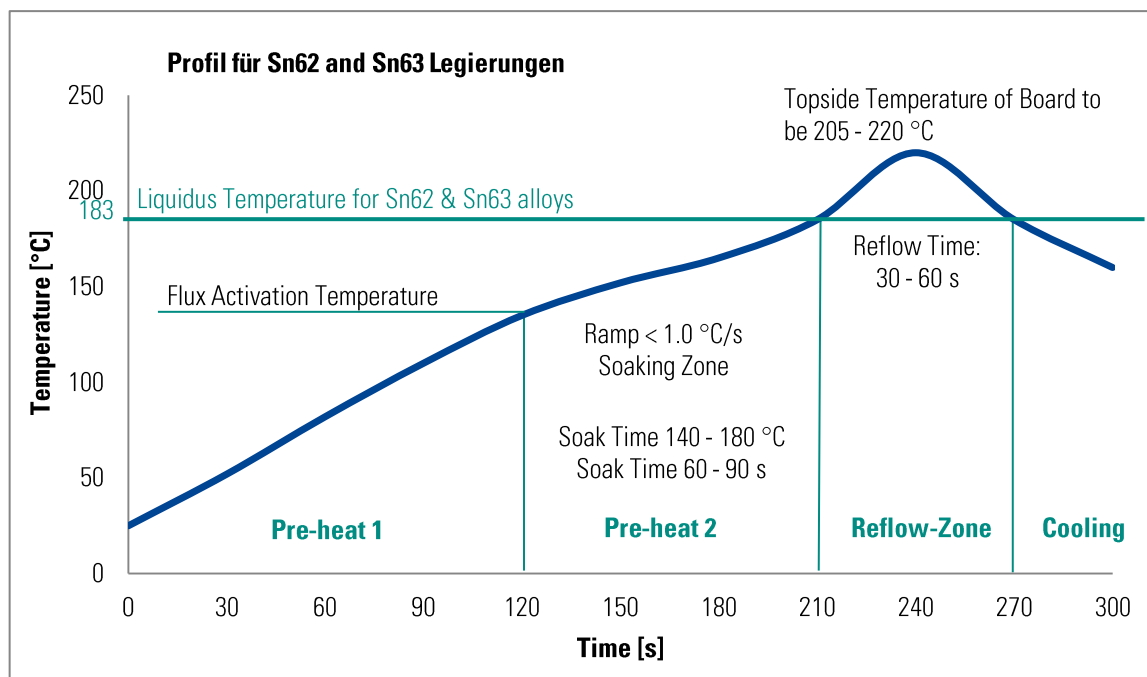
Rakel: Edelstahl

Rakelgeschwindigkeit: 25 – 50 mm/s

Schablone/Sieb: Edelstahl

Umgebung: Optimaler Temperaturbereich 24 – 25 °C, rel. Luftfeuchte 40 – 65 %

### Reflowprofil



Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit oder Gewährleistung kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch bezüglich der Schutzrechte Dritter, nicht übernommen werden.